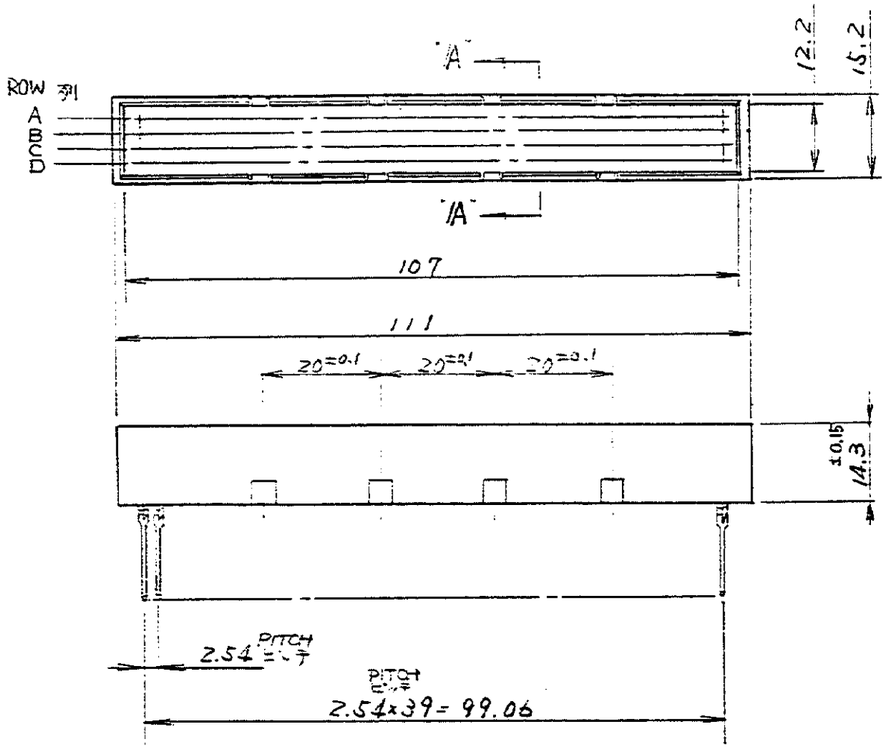
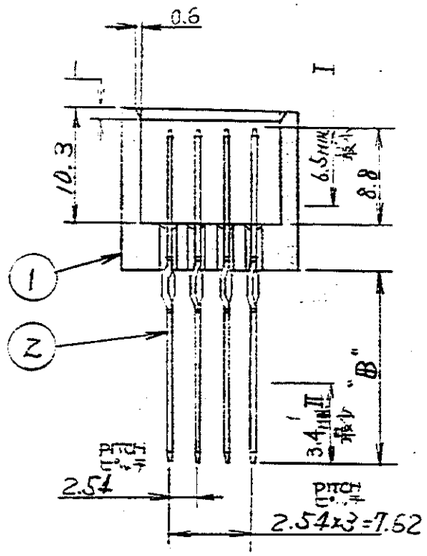




SECT "A-A"

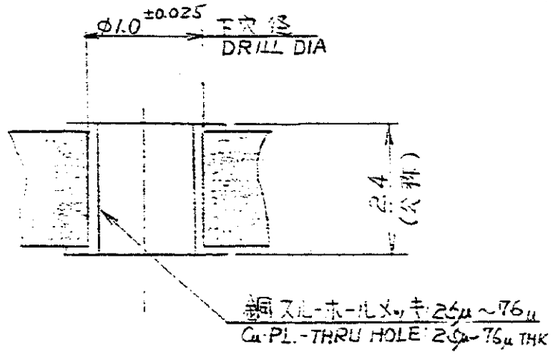
注記

1. 1.3μ以上のニッケルメッキの上にIの範囲に0.76μ最小の金メッキ，IIの範囲及びアクション部に0.1μ最小の金メッキを施す
2. 1.3μ以上のニッケルメッキの上にIの範囲に0.76μ最小の金メッキ，アクション部に0.1μ最小の金メッキを施す.
3. -3,-6はA,B,C列のみコンタクトを挿入してある
4. -4,-5はA,B列のみコンタクトを挿入してある.

NOTES

1. 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ZONE II AND ACTION AREA
2. 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA.
3. -3,-6: INSERT CONTACTS ROW A,B,C ONLY
4. -4,-5: INSERT CONTACTS ROW A,B ONLY

5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



基板穴推奨寸法
RECOMENDED HOLE SIZE

5	4	3	2	1									
—	—	80	120	160	—	9.4 REF.	2	↑	↑	↑		2
120	80	—	—	—	160	16.9 REF.	1	銅合金 COPPER ALLOY	アクションピンポスト ACTIONPIN POST			2
1	1	1	1	1		—	—	ガラス入りPBT GLASS FILLED PBT	ヘッダーハウジング HDR.HSG			1
-6	-5	-4	-3	-2	-1	寸法 DIM "B"	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	名称 NAME			ITEM NO.

OBSOLETE

© 1997年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 1987BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK	DATE
B1	REVISED PER ECO-09-022424	KK		01/09/09
B	-5 追加 J10980	H.A	[illegible]	[illegible]
A	-6 追加 J12080	H.A	[illegible]	[illegible]
0	作成 J9691	[illegible]	[illegible]	[illegible]

圧着電線範囲(WIRE RANGE) mm²(AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm
材質 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 表参照
DR.	DES.
CHK.	APP.

名称 (NAME): HDR ASS'Y S-200 CONN.

一般公差	
10以下	±0.2
10を超え 30以下	±0.25
30を超え 100以下	±0.3
角度	±2°

SYZE: C LOC: J 図番 (NO.): C-174350

尺度 (SCALE): — REV. B1 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位：ミリ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT